

INVESTOR RELATIONS

2019 YMT IR BOOK

Your Most trustworthy



유의사항 [Disclaimer]

본 자료는 한국채택국제회계기준 연결실적에 대한 경영실적 및 재무성과를 바탕으로 작성되었습니다.

또한 본 자료는 미래에 대한 “예측정보”를 포함하고 있으며, 이러한 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 불확실성으로 인하여, 실제 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

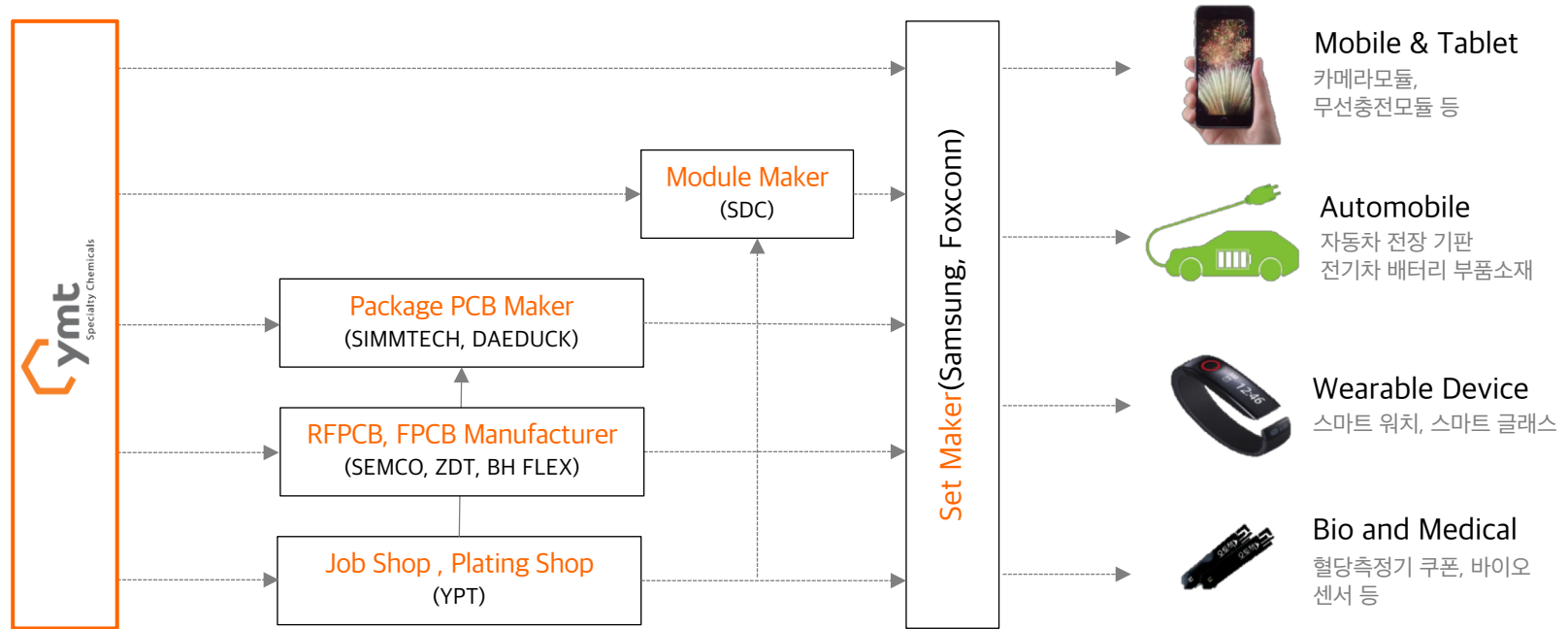
- 국내외 국가정책변경에 따른 세율 변동 (FTA, 관세, 법인세 등)
- 환율 및 이자 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향
- 주요 매출시장의 환경의 예상치 못한 급격한 변화
- 회사내의 전략적인 의사결정

이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과는 중대한 차이가 있을 수 있습니다.



Company Introduction

와이엠티는 PCB 제조공정에 사용되는 고부가가치 표면처리 화학소재를 직접 연구/생산/공급 하는 회사로 High-end 표면처리소재분야에 강점을 둔 Global 화학소재 회사입니다.



한국, 중국, 베트남에 위치한 FPCB, RFPCB 제조사들에게 당사의 화학소재를 공급중에 있으며, 기존 FPCB 표면처리분야의 기술력을 바탕으로 PKG PCB시장, 전자소재로 시장확대중에 있습니다.

Company Introduction

GLOBAL NETWORK

와이엠티는 대한민국을 넘어 더 넓은 세계로 도약하고 있습니다!



YMT China (Shenzhen) Co., Ltd

No.509, Hongan Business Center, Xinqiao Integration BLDG, Beihuan RD, Shajing St, Baoan District, Shenzhen, CN518125
Tel. +86-755-2946-6201

YMT China (Shenzhen) Kunshan Branch

Lujia Town, Kunshan City, Jiangsu Province Hefeng
Village, Jinzhu Road No.18 CN215331
Tel. +86-0512-3669-8439

YMT Taiwan Branch

1F, No.51, Housheng RD, Luzhu City Taoyuan County 338, Taiwan
Tel. +886-3-3220808

Rizhao Factory

South of Shanghai RD, West of Xian Dai RD, Rizhao Economic
Development Zone Rizhao City, Shandong Province,
China 276800
Tel. +86-633-227-8778

YMT VINA (Vietnam) Co., Ltd

F6, Room602, MB Bac Ninh Building, No.24,
Ly Thai To Street, Bac Ninh City, Vietnam
Tel. +84-24-1625-1238 Fax. +84-24-1625-1288

YMT Europe Office

Drahobejlova 1019/27, Praha 9 - Libeň (Zip : 19000)

본사/1공장 HQ/Factory 1

인천광역시 남동구 남동대로 153번길 30
Tel. 032-821-8277 Fax. 032-821-8271

2공장 Factory 2

인천광역시 남동구 청능대로 337
Tel. 032-821-8277 Fax. 070-4009-0403

와이피티㈜ YPT Co., Ltd.

경기도 안산시 단원구 신원로 147
Tel. 031-492-8278 Fax. 031-493-8278

부산출장소

부산광역시 강서구 녹산산단 382로 14번가길 20
부산청정도금센터 406호
Tel. 070-7596-2510 Fax. 051-714-5270

Customer List

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|
| PCB Maker <i>Direct Customer</i> |  |  |  |  |  | |
| |  |  |  |  |  | |
| |  |  |  |  |  | |
| Set Maker |  |  |  |  |  |  |
| Semi-conductor Maker |  |  |  |  | | |
| Display Maker |  |  |  | | | |

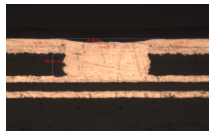
Products Introduction

Chemical Business



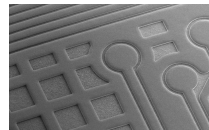
최종표면처리 화학소재

- 기판 표면의 보호와 부식방지를 위해 금, 팔라듐 등의 귀금속을 이용하여 PCB 표면을 도금
 - ✓ FPCB, RFPCB용 금도금 세계 점유율 1위
 - ✓ Apple, Samsung mobile 채택



동도금 화학소재

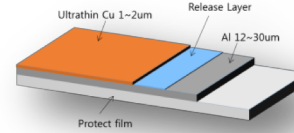
- Multi layer 기판의 층간 전기적 연결을 형성하는 공정
 - ✓ 무전해화학동 : 부도체 물질에 화학적 전도성 부여
 - ✓ 전기동 : 동의 석출로 동 두께를 형성



Process Chemical

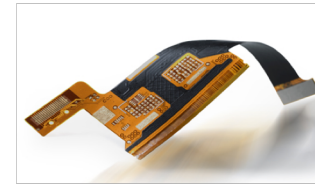
- 기판의 회로를 형성하기 위한 식각, 현상 프로세스 및 기타약품
 - ✓ PCB용 식각, 현상, 감광액 등
 - ✓ MSAP용 회로약품
 - ✓ Flux Cleaner

Others



Electronic Materials

- Materials
 - ✓ Ultra-thin copper Foil
 - ✓ EMI Shield
- Roll to Roll
 - ✓ RTR 동도금 외주



기판 가공 [YPT]

- 금도금외주
 - ✓ FPCB, RFPCB 외주
 - ✓ 카메라모듈기판 외주
- Via-fill 동도금 외주



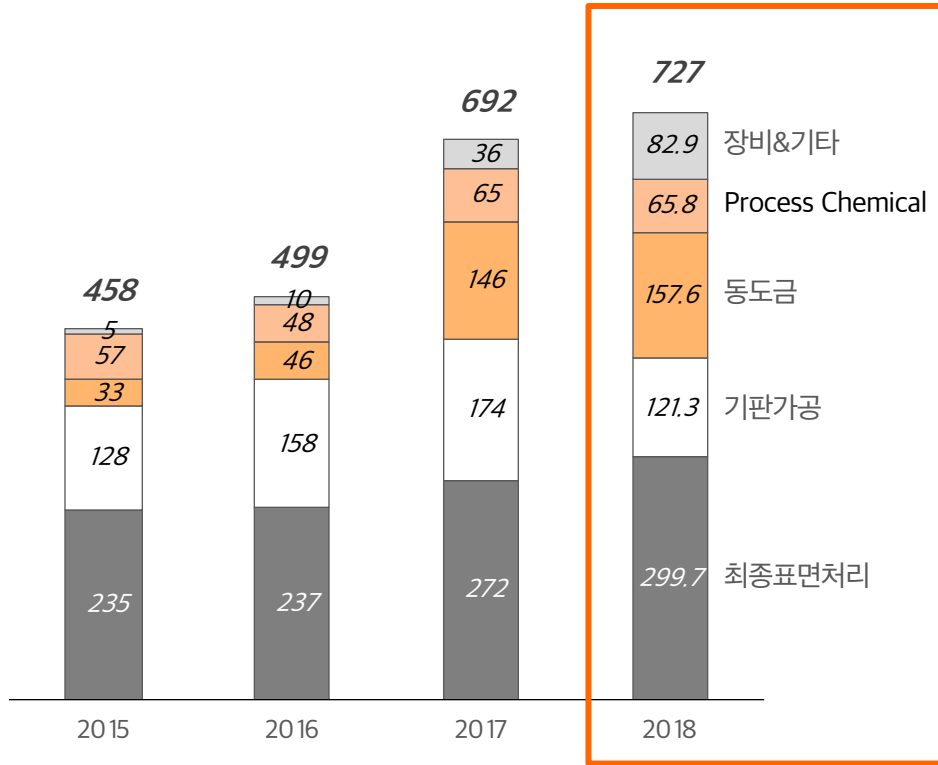
장비매출 [Beyond Solution]

- 금도금, 동도금 장비 판매, 이전 설치 및 유지보수 Service
 - ✓ YMT 약품과 Binding
 - ✓ Via - Fill 장비개조, 고객사 베트남 공장이전 등

Sales Result

■ 최종표면처리 □ 기판가공 ■ 동도금 ■ Process Chemical □ 기타 및 장비

(단위:억원)



• 18년 온기 727억원으로 역대 최대 매출 달성

✓ 17년 대비 35억원 5% 상승

• 최종표면처리 제품의 꾸준한 성장

✓ 전년대비 28억원 상승

✓ 중국, 베트남 시장에서의 고객사 확대

• 장비 매출의 신규 발생

✓ 18년 장비매출 약 60억원 발생

✓ 계열사 비윤드솔루션과 본사 또한 장비 판매 수익

• 기판가공(와이피티) 전년대비 53억원 매출 감소

✓ 국내 금도금 물량의 베트남 이전

✓ Via-Fill 외주의 Delay

2019 Business 전망

1) Foldable 스마트폰의 출시, 2) 5G 시장의 개화



대당 PCB 탑재 수 증가

- 디스플레이 탑재 증가에 따른 대당 탑재 증가
 - ✓ 갤럭시 Fold 에 2개의 패널 장착
 - ✓ 이에 디스플레이용 PCB 증가
- 배터리용 PCB 증가
 - ✓ 디스플레이 면적 및 대수 증가에 따른 배터리팩 증가
- 카메라모듈 수 증가
 - ✓ 총 6개의 카메라 모듈 탑재
- LDS에서 FPCB로 안테나 사양 변화
 - ✓ 5G 고주파 대응을 위한 안테나 대수 증가에 의해 얇은 FPCB로 전환

당사 Major 고객사 수혜 전망
PCB 전체 시장의 규모 증가

PCB 고도화

- SLP 시장 확대
 - ✓ 배터리 등 모듈 확대에 따른 공간 부족
 - ✓ HDI 소형화 필수
- Fine pitch needs 증가
 - ✓ PCB 면적은 줄어드나, 모듈의 증가로 PCB 내 회로 면적 증가
 - ✓ 고객사의 고사양 약품 니즈 증가
- 고다층 PCB 확대
 - ✓ PCB 면적 감소에 따라, 고다층 PCB에 대한 사양 증가
 - ✓ Via Fill 등 하이엔드 고다층 PCB 기술에 대한 시장 니즈 확대

Chemical ASP 상승 예상
주요 고객사와 현재 초도 납품 중

소재의 변화

- 극동박에 대한 니즈 증가
 - ✓ SLP 필수소재로 PCB 경박단소화 트렌드에 필수적인 소재
- EMI 차폐소재 변화
 - ✓ 5G 고주파 대응을 위한 모바일 차폐소재 변화
- 신호전송율 손실 방지를 위한 소재 변화
 - ✓ 5G 에서 가장 중요시되는 신호손실방지를 위한 다양한 소재와 공법의 변화가 요구됨
 - ✓ 저조도동박, 무에칭조도형성공법 등

Nanotus 개발중(무에칭공법)
주요 고객사와 극동박 test 중

2019 Business 전망

Market Forecast

- Mobile 관련 PCB 생산은 전년대비 비슷한 수준으로 전망, 전장, 의료 등 타분야 성장
- 한국 → 베트남으로의 PCB 생산기지 이동 가속화
- 폴더블 & 5G 의 개화 원년으로 관련 매출 발생 및 상승

Chemical Business

최종표면처리

- 북미 모바일 제조사 OLED 비중확대에 따른 관련 소재 매출 확대전망
- 듀얼, 트리플 카메라 비중확대에 따른 중국 시장 매출 성장 (카메라모듈)
- 본격적인 고객사의 베트남 공장 양산으로 해당 시장에서의 성장을 기대

동도금

- 고객사 내 점유율 확대와 시장 물량 확대(북미 모바일 제조사)로 성장 전망
- 전기동 (Via-Fill) 신규 매출 확대

Process Chemical

- SLP 및 Package 기판 (반도체 실장 기판) 관련 신규 고객사 확보 및 매출 확대 전망
- Nanotus, 저조도에칭 프로세스 등 5G 관련 신규 프로세스 시장 진입

Others

기판외주가공(YPT)

- 베트남 공장 완공 4월 예상으로 하반기 외주물량 양산 예정 (고객사 협의중)
- 국내의 경우 Via Fill (전기동도금외주) 양산 예정 전년보다는 물량 확대 전망

소재사업부문

- 국내 제조사 Signage (OLED 전광판) 관련 매출 발생
- EMI 차폐 현재 고객사 프로모션 중
- 전해박 Biz (중국 N사 동박 수입) 양산 승인중으로 상반기 양산, 공급 예정

기계장치, 상품 등

- 고객사 해외이전으로 비온드 솔루션 관련 매출 상승 및 고사양 PCB 도금 장비 매출 확대
- 장비 Biz 중국시장 런칭

Income Statement

(단위:억원)

| | 제 20기 | 매출비중 | 제 19기 | 매출비중 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|
| I. 매출액 | 727.4 | 100% | 691.9 | 100% |
| II. 매출원가 | 447.9 | 61.6% | 415.3 | 60.0% |
| III. 매출총이익 | 279.5 | 38.4% | 276.6 | 40.0% |
| 판매비와 관리비 | 135.6 | 18.6% | 115.5 | 16.7% |
| IV. 영업이익 | 143.9 | 19.8% | 160.8 | 23.2% |
| 기타수익 | 8.9 | 1.2% | 14.2 | 2.1% |
| 기타비용 | 23.9 | 3.2% | 12.7 | 1.8% |
| 금융수익 | 13.5 | 1.9% | 3.2 | 0.5% |
| 금융비용 | 23.5 | 3.2% | 44.8 | 6.5% |
| 지분법손실 | 0.3 | 0.0% | - | - |
| V. 법인세차감전순이익 | 118.6 | 16.3% | 120.6 | 17.4% |
| 법인세비용 | 20.7 | 2.9% | 30.4 | 4.4% |
| VI. 당기순이익 | 97.9 | 13.5% | 90.1 | 13.0% |

주요 수익성 지표

| | 20기 | 19기 |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 영업이익률 | 19.8% | 23.2% |
| 순이익률 | 13.5% | 13.0% |
| EBITDA (마진율) | 163.4 (22.46%) | 155.0 (22.40%) |
| ROE | 12.01% | 14.20% |
| 총자산회전률 | 57.24% | 60.71% |

Balance Sheet

(단위:억원)

| | 제 20기 | 제 19기 |
|-------------|----------------|----------------|
| 자산 | | |
| 현금성자산 | 276.1 | 224.2 |
| 매출채권 | 206.6 | 228.1 |
| 유형자산 | 560.5 | 465.3 |
| 기타자산 | 227.6 | 222.1 |
| 자산총계 | 1,270.8 | 1,139.7 |
| 부채 | | |
| 매입채무 | 37.8 | 37.6 |
| 차입금 | 329.9 | 346.7 |
| 전환사채 | 68.9 | - |
| 기타부채 | 90.1 | 90.4 |
| 부채총계 | 526.7 | 474.7 |
| 자본 | | |
| 자본금 | 37.0 | 18.5 |
| 자본잉여금 | 219.5 | 232.7 |
| 이익잉여금 | 403.4 | 334.6 |
| 기타자본 | 84.2 | 79.2 |
| 자본총계 | 744.1 | 665.0 |
| 부채와 자본계 | 1,270.8 | 1,139.7 |

Cash Flow

(단위:억원)

| | 제 20기 | 제 19기 |
|----------------|---------|---------|
| 기초현금 | 224.2 | 108.5 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 176.0 | 81.6 |
| 순이익 | 97.9 | 90.1 |
| 감가상각비 | 37.5 | 27.2 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (160.7) | (167.9) |
| 유형자산의 증가 | (120.3) | (167.7) |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 33.6 | 210.6 |
| 차입금 증감 | 53.2 | 93.1 |
| 자기주식(취득)처분 | (19.6) | 13.2 |
| 전환사채 발행 | 70 | - |
| 신주발행(유상증자) | - | 104 |
| 현금증감 | 48.9 | 124.3 |
| 환율변동효과 | 3.0 | (8.5) |
| 기말현금 | 276.1 | 224.2 |

END OF DOCUMENT

감사합니다.